

MWC 2015 : la mobilité d'Intel passe par le Cloud, la 5G et LTE

Barcelone – Intel entend jouer un rôle majeur dans le monde de la mobilité au-delà de son offre de processeurs pour laptop, smartphone et autres tablettes. « *Nous apportons une solution complète du silicium au terminal en passant par la transformation du réseau* », a déclaré Brian Krzanich (notre photo), le CEO, au Mobile World Congress (MWC), en introduction aux nouvelles solutions de la firme.

A commencer par la récoltes des premiers fruits tirés de ses partenariats avec plusieurs acteurs de l'industrie pour fournir une infrastructure définie par logiciel (Software defined infrastructure) résultant d'une « *architecture ouverte dans le hardware et le software* ». C'est notamment le cas d'**Alcatel-Lucent** avec sa nouvelle **solution d'accès réseau radio virtualisé (vRAN) basée sur une unité baseband virtualisée (vBBU)** qui s'appuie sur un processeur Xeon. Intel déclare avoir collaboré avec l'équipementier français autour de la virtualisation des fonctions réseau (NFV). Autre partenariat avec Ericsson qui a annoncé une nouvelle génération de **plate-forme pour datacenter** basée sur l'architecture Rack Scale d'Intel. Une collaboration qui se poursuit également autour de l'Open Platform for NFV. C'est aussi sur une architecture Intel que **Huawei** développera sa prochaine génération de **solutions Cloud FusionSphere** tout en poursuivant des codéveloppements dans les technologies de virtualisation (à travers l'utilisation de Data Plane Development Kit (DPDK) et OpenvSwitch). Enfin, Intel et l'opérateur **SK Telecom** travaillent de concert dans **la 5G** à travers la technologie **Anchor-Booster Cell** visant à combiner LTE et Wifi. Autant de solutions qui promettent de « *conduire l'infrastructure du Cloud à un coût bien plus bas* » en s'affranchissant des formats propriétaires.

X3, premier Atom à intégrer la connectivité

Brian Krzanich est également revenu sur la pré-annonce des [nouveaux Atom](#) pour apporter quelques détails. Les Atom 64 bits X5 et X7 (nom de code Cherry Trail), les premiers à être gravés en 14 nanomètres, adresseront les marchés des tablettes et laptop 2-en-1 balayant de l'entrée au haut de gamme sous Android comme Windows. **Le X3** (nom de code Sofia) pour sa part vise les smartphones et tablettes uniquement. Il se distingue par l'intégration, pour la première fois, de la connectivité 3G ou 4G ainsi que des capteurs graphiques, audio et de la gestion de la consommation des composants. Avec **l'Atom X3, Intel marche donc enfin sur les pas de Qualcomm** qui s'illustre de longue date en intégrant les composants radio et multimédia à ses Snapdragon. Des composants qu'Intel entend accompagner de technologies transverses comme **la plate-forme Real Sense** pour tirer parti des capteurs, les chargeurs sans fil par induction ou encore ses solutions de sécurité héritées de McAfee que le fondateur entend proposer aux constructeurs de smartphones (c'est le cas des Galaxy S6 et Edge de Samsung) y compris les montres connectées (LG) pour en protéger la confidentialité des données. L'offre d'Intel a séduit nombre de partenaires tels que Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ou Toshiba. Pas moins de 20 partenariats à travers 27 designs ont ainsi été annoncés à Barcelone.

Intel poursuit d'ailleurs les développements de son offre de connectivité et a dévoilé **le XMM 7360**,

un modem LTE-Advanced de catégorie 10 supportant trois agrégations de porteuses pour délivrer du 450 Mbit/s en réception. Un composant que le fondeur destine aussi bien aux smartphone et tablettes qu'aux PC et devrait apparaître dans le courant du second semestre. Enfin, comme pour se tourner vers l'avenir, Brian Krzanich a évoqué les avancées des technologies Intel en matière de pré-5G avec la démonstration d'un système combinant LTE et 802.11ad (du Wifi à 60 GHz) pour atteindre 1 Gbit/s de bande passante.

Lire également

[Semi-conducteurs : Intel vise le 10 nm... Et après ?](#)

[Intel espère vendre 44 millions de composants pour tablettes en 2015](#)

[CES 2015 : Intel lance ses puces Broadwell à l'assaut de la mobilité](#)